

JCU REPORT

株主・投資家の皆様へ

第64期 中間報告書

2023.4.1 ▶ 2023.9.30 | 証券コード：4975

● トップインタビュー

14期連続の増配へ、 半導体向け薬品ブランド 「TIPHARES(ティファレス)」立ち上げ

2024年3月期の9月中旬は減収減益となりました。
通期予想は据え置きとしています。

コロナ禍の巣ごもり需要が終息したことに伴い、スマートフォンをはじめとする高機能電子機器の需要が世界的に低水準で推移し、プリント基板及び半導体パッケージ基板の需要が減少したことが大きく影響しました。しかし、四半期別に見ると、地域によって差はあるものの、第1四半期が底で、第2四半期は上向きに転じています。台湾、韓国の回復は鈍い状況が続いているものの、足元の回復状況を鑑みて、通期については売上高250億円、営業及び経常利益70億円、親会社株主に帰属する当期純利益48億円の予想を据え置きました。2022年5月に上方修正し、過去最高の売上高・利益を目指す中期経営計画の2024年3月期の目標は大変残念ながら未達となる見通しですが、株主配当については14期連続の増配を目指していきます。なお、次期中期経営計画は現在策定中のため、詳細はお話しできませんが、お示しできる段階になりましたら、改めて発表させていただきます。

半導体向け表面処理薬品の新ブランド 「TIPHARES(ティファレス)」を立ち上げました。

当社は電子分野において、プリント基板及び半導体パッケージ基板向けの薬品を中心に拡販を強化し、成長してきました。そこで得られた知見を活かし、半導体分野向けの薬品を強化していくため、半導体向け表面処理薬品の新ブランド「TIPHARES(ティファレス)」を立ち上げました。まずは、半導体チップ同士を高密度に配線接続する「後工程」向けの薬品である再配線層向け銅めっき薬品と、スパッタシード層一括エッチング薬品を市場投入します。今後は後工程に限らず、次世代半導体に必要とされるシリコン貫通電極(TSV)やメガピラー(垂直方向の接続電極)対応の表面処理薬品を随時市場投入するほか、ハイブリッド接合対応薬品の研究を東北大学と共同で進めていきます。これにより半導体の高速処理や省電力化が期待でき、自動運転や生成AI(人工知能)などのデジタル社会の発展に貢献します。ちなみに、TIPHARESはTiphereth(美)とsemiconductor(半導体)を合わせた造語で「半導体の機能美」を表しています。

半導体関連企業の進出相次ぎ 熊本事業所(仮称)の存在感増す、 東南アジアはタイを軸に連携強化

土地代を含め約84億円を投資し、
熊本県上益城郡益城町に半導体関連薬品の
研究開発及び製造拠点となる
熊本事業所(仮称)を2025年に竣工する計画です。

熊本県は台湾積体回路製造(TSMC)をはじめとする半導体関連企業が進出しており、日本は電子国家に向かっていきます。当社としては今後も成長を遂げるために、熊本県に拠点を設立し、情報収集及び開発に注力していきます。さらに、熊本事業所(仮称)はスマートファクトリー、カーボンニュートラル等を見据えた最新鋭の事業所にする計画です。製造拠点を生産本部(新潟県上越市)と分散することで、非常事態発生時

のBCP(事業継続計画)対応も図れます。今後は、既存の電子及び装飾・機能分野のお客様に加え、半導体向け表面処理薬品に関するお客様の要望にきめ細かく、タイムリーにお応えしていきたいと考えています。

海外では、東南アジアにおける「東西回廊」形成と 横の連携強化を打ち出しています。

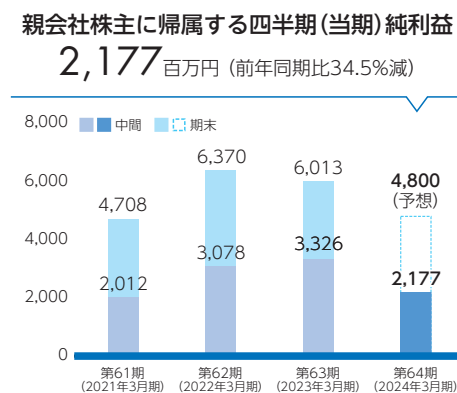
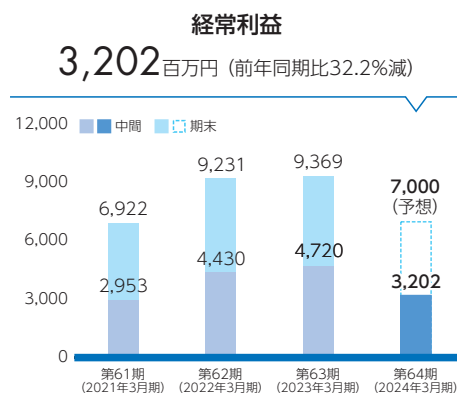
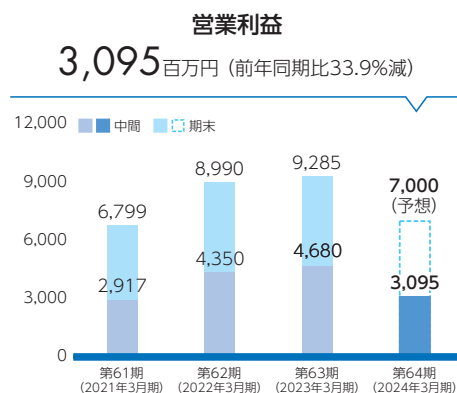
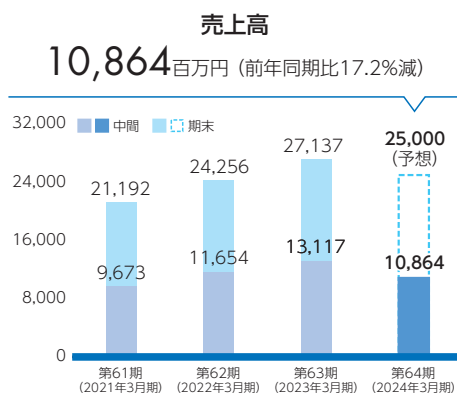
2023年5月にマレーシア現地法人が開所式を行い、本格稼働しました。東南アジアにおける拠点はタイ、ベトナム、インドネシアに次いで4か国目となります。インド現地法人を含め体制が整ってきました。当社は海外での売り上げが7割を超えており、中国、台湾、韓国の重要性は何ら変わりませんが、集中リスク分散の観点から、東南アジアを重視しています。

そのなかで、欧米企業を含め、中国、台湾のお客様がタイにシフトしているケースが多くなっています。タイは自動車産業の集積地でもあり、当社の現地法人は自動車向け、電子部品向けの両方の表面処理薬品を展開しています。今後、ビジネスチャンスが拡大していくとらんでいます。

株主・投資家の皆様におかれましては、これまで以上のご愛顧ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

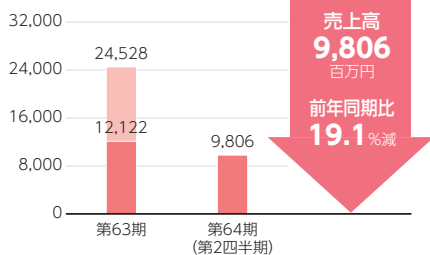


● At a Glance

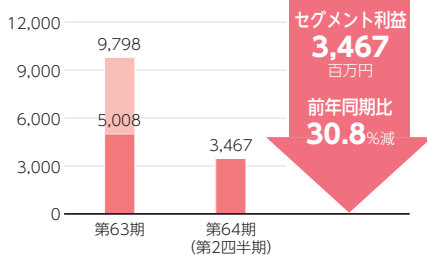


薬品事業

売上高 (単位:百万円)



セグメント利益 (単位:百万円)



電子分野

中国 一部のプリント基板メーカーにおいて回復基調がみられるものの、スマートフォンをはじめとする高機能電子デバイス向けプリント基板の需要が減少し、薬品売上高は減少いたしました。

台湾 サーバー、高機能電子デバイス向け半導体パッケージ基板の需要が減少し、薬品売上高は減少いたしました。

韓国 半導体市場の低迷が継続したため、半導体パッケージ基板の需要が減少し、薬品売上高は減少いたしました。

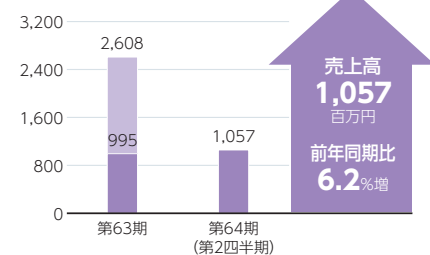
装飾分野

日本 半導体・部品不足が緩和されたことにより、自動車の生産台数が回復基調となりましたが、薬品売上高は横ばいに推移いたしました。

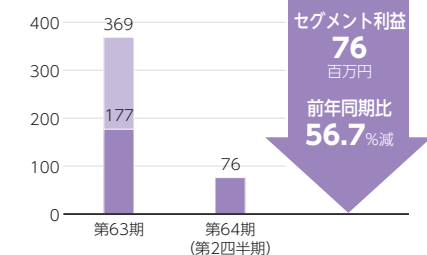
中国 半導体・部品不足の緩和に伴い、自動車の生産・販売台数は増加したものの、当社が対象とする自動車部品の需要が減少し、薬品売上高は減少いたしました。

装置事業

売上高 (単位:百万円)

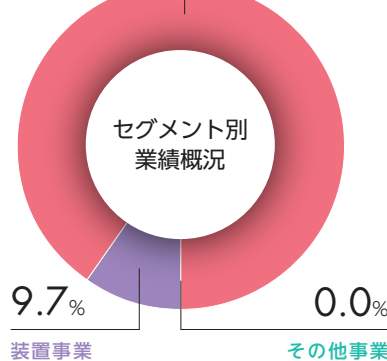


セグメント利益 (単位:百万円)



薬品事業

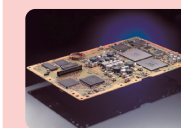
90.3%



その他事業

その他事業におきましては、売上高は0百万円(前年同期比42.8%減)となり、セグメント損失は8百万円(前年同期はセグメント損失8百万円)となりました。

薬品事業 使用例



プリント基板



自動車部品

装置事業 製品一例



全自動表面処理装置

新型コロナウイルス感染症の影響による先送り案件の再開及び新規投資需要の増加により、売上高は増加、受注残高は大幅に増加いたしました。

TOPICS

プリント基板製造におけるJCUの役割

Q プリント基板とは？

A 私たちが生活するうえで使用する電子機器のほぼ全てに使用されている電子部品の1つで、電気を通さない絶縁体（樹脂）の表裏及び内部に電気を流すために金属（銅）の配線が形成された板の総称です。リジッド基板、フレキシブル基板、半導体パッケージ基板など多様な種類が存在し、様々な製品の起動や各種制御を行ううえで必要となります。

近年では電子機器の高性能化及び小型化によるプリント基板の多層化が進んでおり、縦横方向へ電気を流すための配線が必要となっております。

Q JCUの役割は？

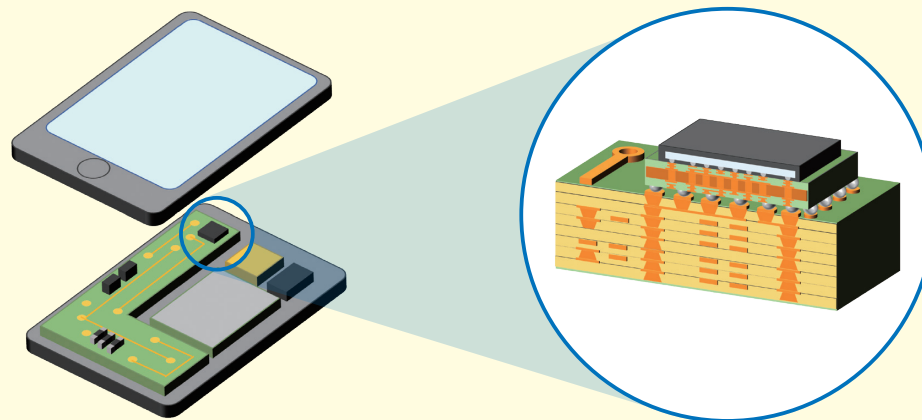
A 当社の薬品は金属の配線を形成する際に使用されている表面処理薬品です。ビアフィリング薬品は、縦方向へ電気を流すためにビアと呼ばれる孔に金属を充填する際に用いられ、エッチング薬品は最終的に不要となる薄い金属の層（シード層）を剥がす際に用いられます。いずれも金属の配線を形成する際の重要な役割を担っております。

Q 今後の動向について

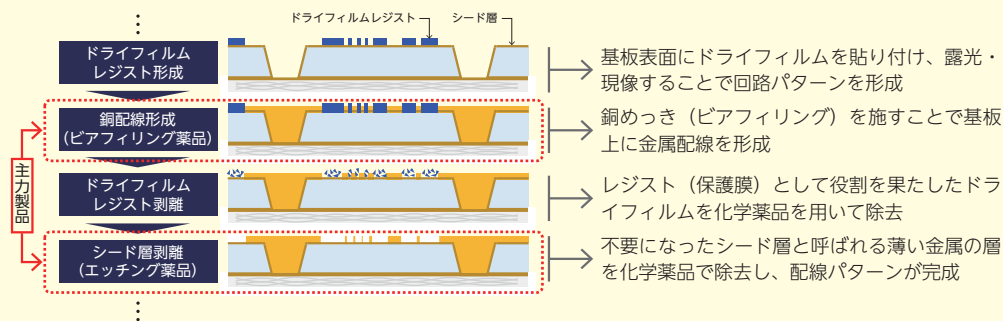
A ビッグデータ、AI、IoTをはじめとするIT技術の進歩に伴い、プリント基板の用途は拡大していくことが予想されます。

そのような市場環境において、当社表面処理薬品の需要も増加傾向にあり、次世代技術への投資を行いつつ、これからも世の中のニーズに応えられる製品を提供し続けてまいります。

● 電子機器に含まれるプリント基板の断面イメージ図



● プリント基板製造における配線形成フローの一部



用語解説

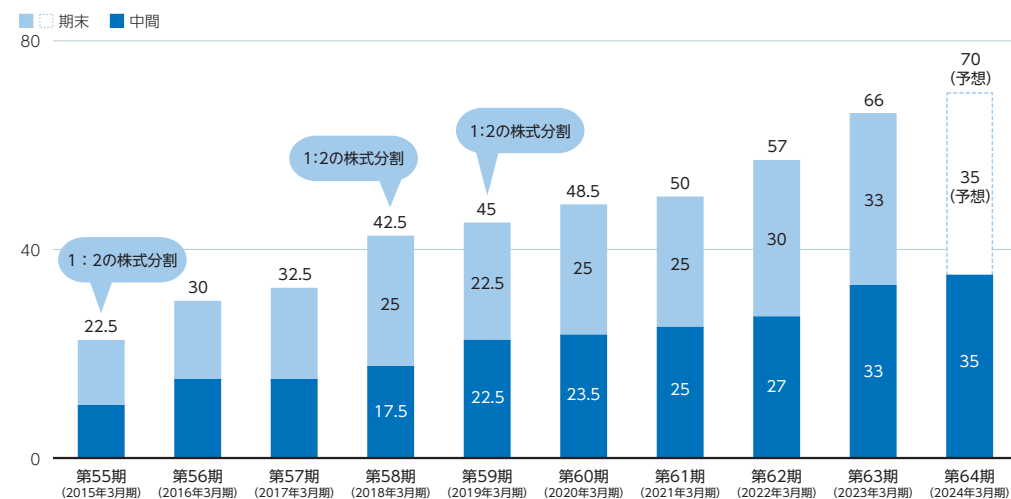
リジッド基板	硬く強度が高い樹脂を基材に用い、電子部品を実装した一般的なプリント基板
フレキシブル基板	薄く柔らかいベースフィルムを基材に用い、折り曲げたり形を変えたりすることができるプリント基板
半導体パッケージ基板	半導体 (ICチップ) を外部環境から保護し、プリント基板に実装する際に外部接続端子の役割をする微細な基板
ピアフィリング薬品	プリント基板や半導体パッケージ基板の層間を電氣的に接続するため、ビア (孔) を銅めっきで充填する薬品のこと
エッチング薬品	薄いシード層 (銅) を化学反応によって剥がし、指定されたパターンの形にするための薬品のこと
ドライフィルムレジスト	露光された部分が硬化する感光性のフィルムで、必要な箇所に銅配線を形成する際に使用される保護膜のこと
シード層	絶縁体の樹脂上にめっき技術を用いて銅配線を形成する際に必要となる薄い金属層のこと

● 株主還元について

利益分配に関する基本方針

当社は、持続的な成長を達成するため手元流動性を確保し、安定した財務基盤を維持しつつ、成長投資を継続してまいります。配当は、安定増配基調継続を目指し、機動的な自己株式の取得による株主還元の実施を基本方針としております。

配当金 (円)



(注) 2014年10月1日付、2017年4月1日付、2018年4月1日付でそれぞれ普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2019年3月期以前については、当該分割後を基準に算出した数値を表示しております。



株式会社 JCU

〒110-0015 東京都台東区東上野四丁目8番1号 TIXTOWER UENO 16階
TEL: 03-6895-7001 FAX: 03-6895-7021
<https://www.jcu-i.com/>

サステナビリティレポート2023の発行

ESGを踏まえた長期視点から経営方針や取り組みを報告するツールとして、当社は2017年からCSRレポートを発行してまいりました。

2023年からは、中長期的な企業価値向上を実現するための価値創造プロセスや部門ごとの事業活動報告などを加え、サステナビリティレポートとして、さらなる内容の充実化を図っております。

本レポートの報告対象期間は2022年4月1日から2023年3月31日までとなっており、当社WEBサイトよりダウンロードが可能となっております。



サステナビリティレポート 2023

中間報告書に関するお知らせ

これまで株主の皆様へお届けしておりました中間報告書につきまして、インターネットやスマートフォンの普及及び地球環境等に配慮した省資源化の観点から、今回より紙面での発行を取りやめさせていただくことといたしました。

今後は当社WEBサイト (<https://www.jcu-i.com/ir/materials/>) に掲載いたします。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

